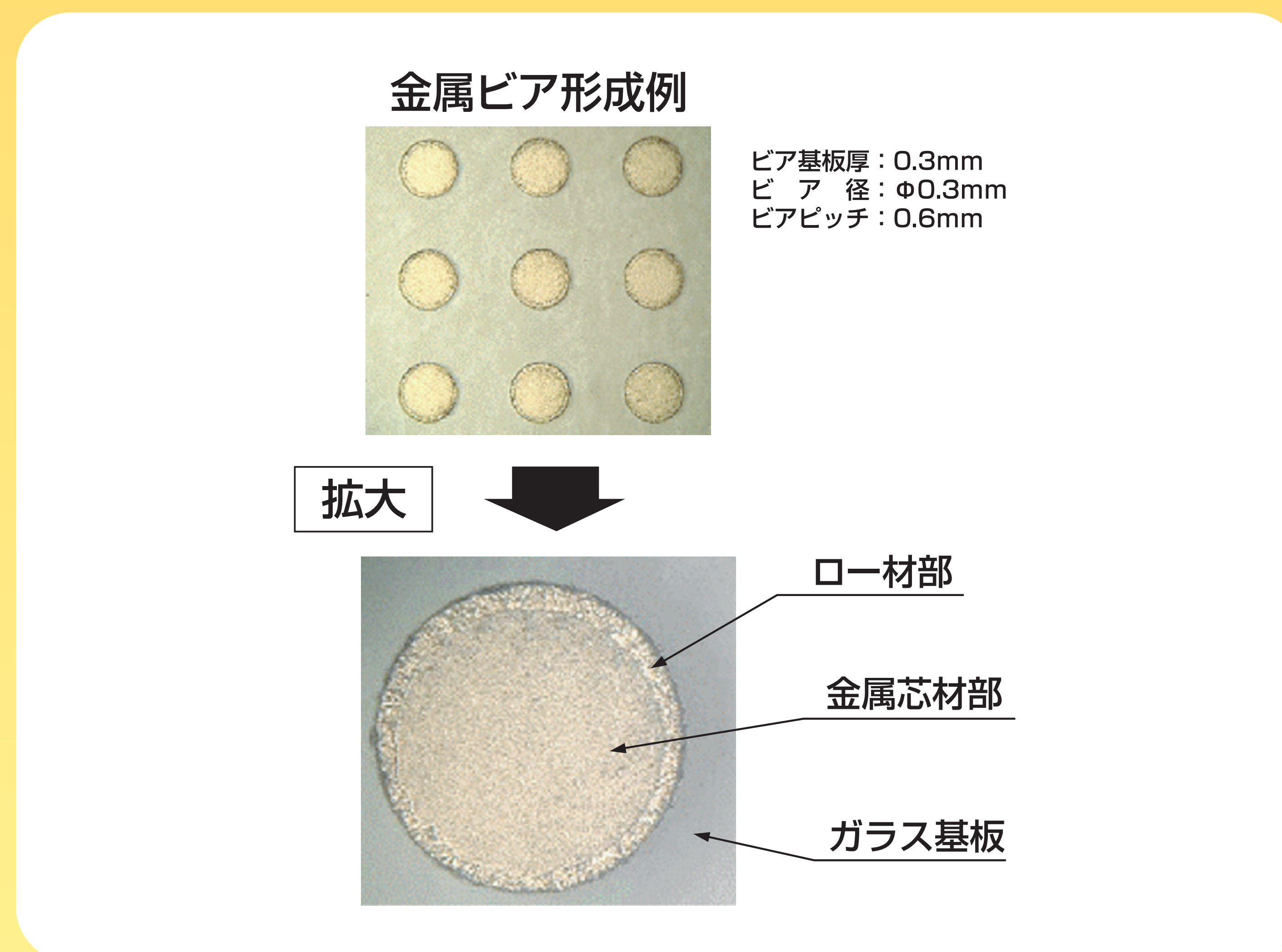


電気・電子部品賞

金属ビアを形成したガラス基板



製品プロフィール

開発製品は次世代半導体として期待されるMEMSの心臓部であるシリコン基板の「ふた」となる封止用ガラス部品。導電用の金属ビアを埋め込み、電気信号を直接外部へ取り出すことが可能。セラミックスと違い、シリコン基板との陽極接合による直接接合が可能になり、実装にかかるボンディングなどの手間が省けると共に小型化が図れる。

用途

- ・高周波用スイッチ／リレー、加速度&加速度センサー用です。
- ・圧力センサー、バイオセンサーなどへ用途が拡大されます。

株式会社テクニスコ